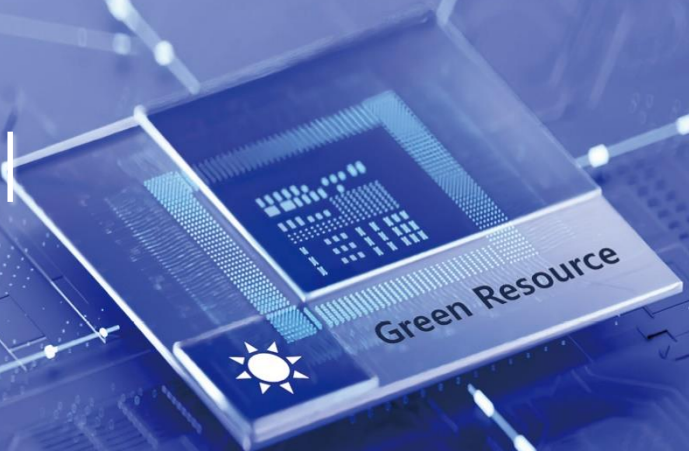
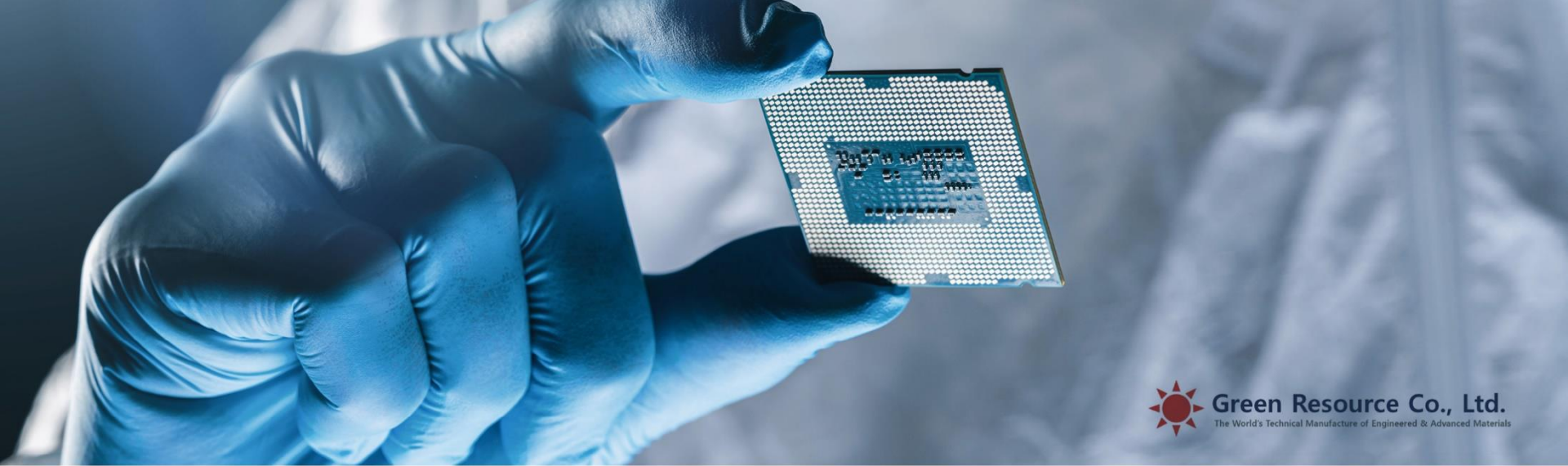


세계 최고의 독보적 반도체 초고밀도 특수코팅 기술 보유
첨단 핵심소재 부품 강소기업

INVESTOR RELATIONS 2024

반도체 소재, 표면처리, 장비 Technology Game Changer





Disclaimer

이 자료는 기관투자자와 일반투자자들을 대상으로 실시되는 투자미팅에서의 정보제공을 목적으로 주식회사 그린리소스(이하 “회사”)에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인 에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바 입니다.

본 투자미팅에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 관련 증권거래 법률에 대한 위반에 해당 될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 회사의 경영실적 및 재무성과와 관련된 모든 정보는 한국채택 국제회계기준에 따라 작성되었습니다. “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래에 발생할 사건과 관련된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘예정’, 등과 같은 단어를 포함 합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 “예측정보”에 기재 되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 투자미팅 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려 드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 주식의 모집 또는 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

COMPANY OVERVIEW

01 회사개요

02 연혁

03 핵심사업 - 초고밀도특수코팅

04 핵심사업 - 초전도선재 장비제작



Green Resource Co., Ltd.

The World's Technical Manufacture of Engineered & Advanced Materials

일반 현황

회사명	(주)그린리소스
대표이사	이종수, 이종범
설립일	2011년 4월 6일
자본금	40.9억원
주요사업	용사 코팅 및 코팅소재 (반도체 & 디스플레이) 초고밀도 코팅 (반도체) 초전도선재 제조 장비 (핵융합발전)
임직원수	76명(2024.9월 현재, 종속회사 포함)
소재지	인천광역시 서구 파랑로 470
홈페이지	www.greenresource.kr

이종수 CEO (경영총괄)

- 벤처기업부장관표창
- 벤처기업진흥유공 국무총리 표창
- 나노융합대전 산업기술부문 산업통상자원부장관상
- 인천시장 표창
- 성균관대 경영대학원 MBA



이종범 CEO (기술총괄)

- 한국산업기술평가원 연구과제 평가위원
- 인천생산기술연구원 희소금속센터 자문위원
- 한국공학대학교 신소재공학박사



코팅 소재부터 장비, 응용 기술 내재화 및 적용 시장의 지속적 확대

희토류 관련 소재들의
다양한 제조 기술 확보

2011~

- 2011 회사설립
- 2012 중소기업청 수출유망중소기업 선정
- 2013 반도체 디스플레이 플라즈마 식각장비 보호코팅 분말
특허등록 및 국산화 성공
- 2014 Nano Award 2014 산업통상부장관상 수상
- 2015 반도체 초고밀도 보호코팅 특허 출원
(글로벌 Top-Tier 기술)

반도체·디스플레이 식각장비
부품 코팅 시장 진입

2016~

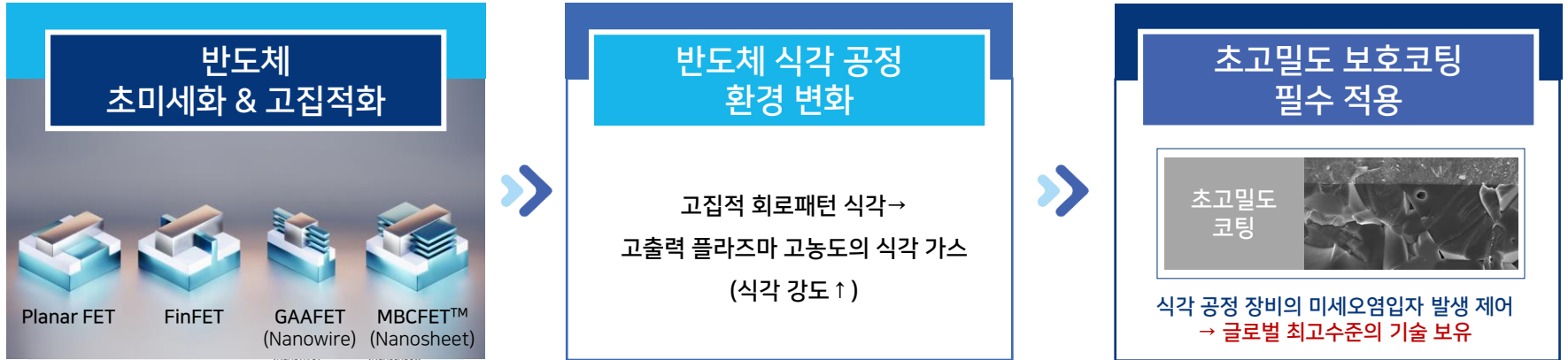
- 2016 고밀도 후막 제조용 코팅 소재 기술 개발
- 2017 초고밀도 코팅 양산기술 확보
Global Foundry 식각장비 보호코팅 메인벤더 등록
- 2018 (주)파이널텍 출자 설립(100% 자회사)
벤처기업진흥유공 국무총리 표창 수상
초고밀도 코팅 특허 등록
중국 1위 식각장비 기업(NAURA) 코팅 부품 공급
- 2019 뿌리기술전문기업 지정
삼백만불 수출의 탑
LG디스플레이 식각장비 보호코팅 공급업체 등록

글로벌 선도 고객사 확보
반도체 초고밀도 코팅 시장 선도

2020~

- 2020 (주)위드엘씨 지분인수 및 100% 자회사 편입
다중전극 구조 플라즈마 용사 장치 개발
글로벌 선도 고객사 초고밀도 코팅 적용
- 2021 초고밀도(특수소재) 코팅 원천기술 확보
Micron(대만) 특수코팅 양산 승인
초전도선재 장비 및 소재사업부 신설 및 장비 수주
(In-line IBAD system)
- 2022 글로벌 강소기업 지정
글로벌 선도 고객사 초미세 공정(특수소재) 코팅 적용
- 2023 KIOXIA(구, TOSHIBA) 식각장비 부품코팅 적용

10nm이하 반도체 식각 공정의 수율 상상을 위한 필수 보호코팅



글로벌 파운드리 3사 선단공정 Roadmap

Foundry	1H22	2H22	1H23	2H23	1H24	2H24	1H25F	2H25F	1H26F	2H26F	2027F
SAMSUNG	SF3E 3nm 1세대 (GAA)				SF3 3nm 2세대 (GAA)		SF2 2nm (GAA)				SF1.4 1.4nm (GAA)
tsmc		N3 3nm 1세대 (FinFET)			N3E 3nm 2세대 (FinFET)			N2 2nm (GAA)		A16 1.6nm (GAA)	A14 1.4nm (GAA)
intel	Intel7 10nm (FinFET)	Intel4 7nm (FinFET)		Intel3 7nm (FinFET)	20A 2nm (GAA)	18A 1.8nm (GAA)					

*자료 : 각 사, 한국투자증권

반도체 건식 식각장비의 핵심 부품 보호코팅

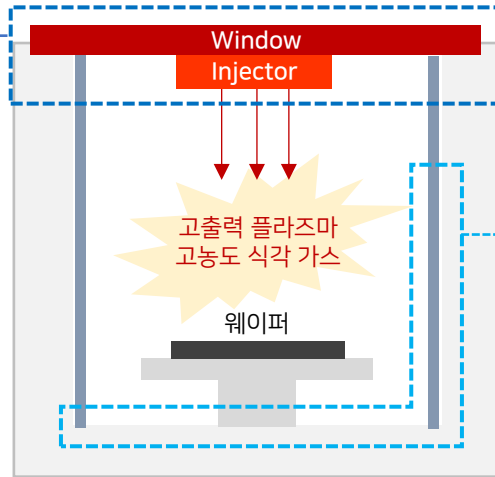
초고밀도(Super Dense) 코팅

자체 개발한 PVD 방식의 초고밀도 코팅으로 식각 챔버의 상부 부품 등 핵심 부품에 대한 내플라즈마 코팅



“ 세계 최고 수준의 독보적 기술 ”

[건식 식각 공정 챔버]



SPS(Suspension Plasma Spray) 코팅

기존 APS 코팅 대비 치밀한 코팅막 형성으로 높은 밀도와 수명을 구현하는 차별화된 기술



[GDP, Inner liner, Outer liner, Shutter 등]

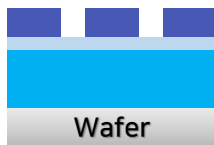
“ 기존 APS코팅 대체 선도 기술 ”

반도체 주요 공정

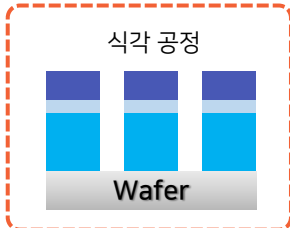
증착 공정



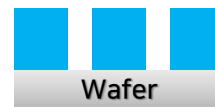
노광 공정



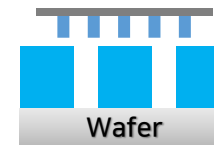
식각 공정



박리 공정



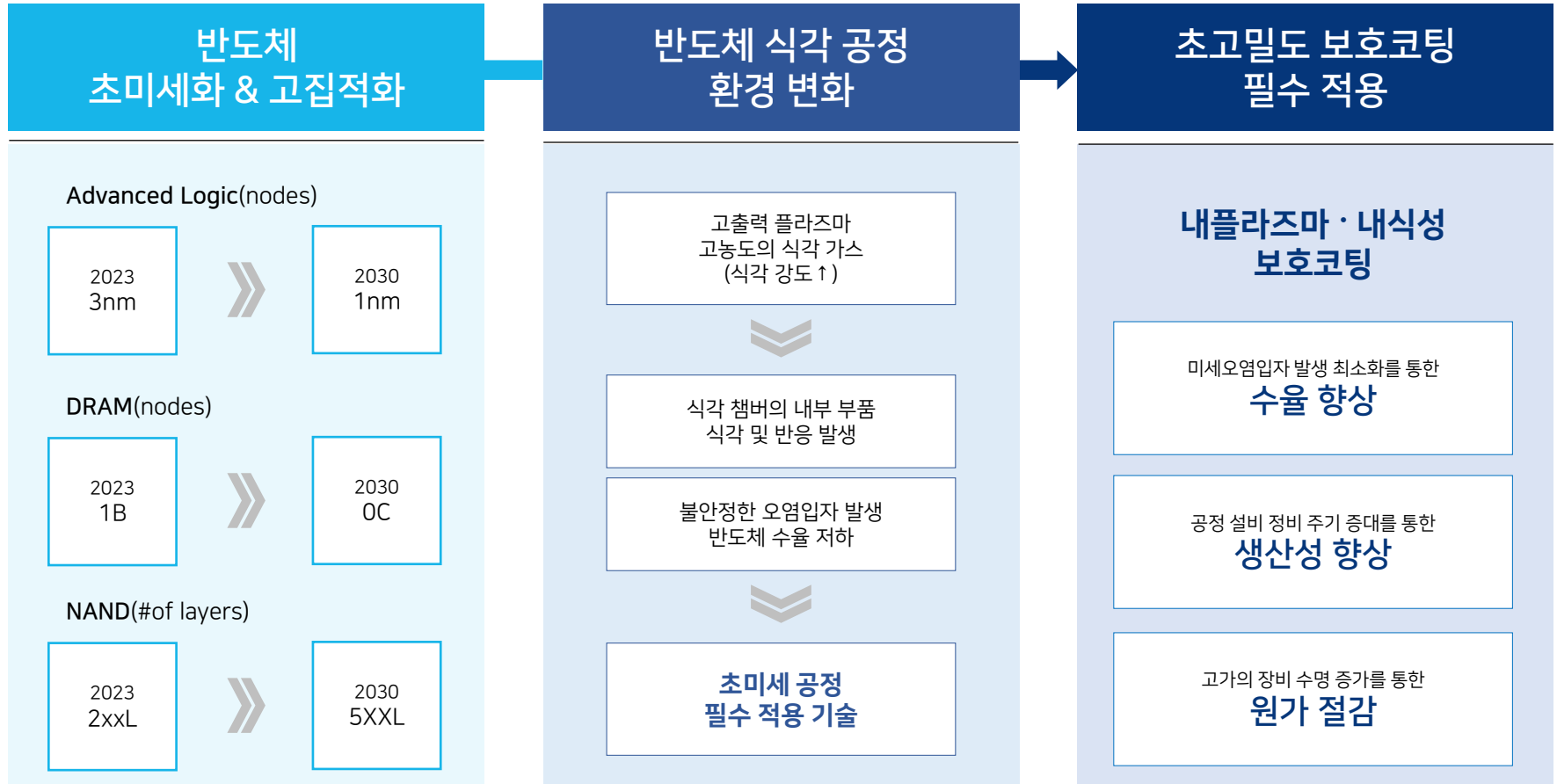
세정 공정



증착 공정



가혹한 식각 공정의 미세오염입자 발생 제어



*자료 : ASML, 현대차증권

04 초전도선재 IBAD 증착 장비

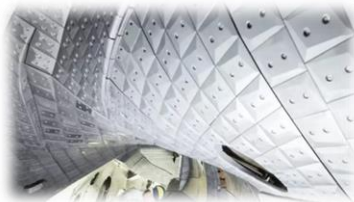
핵융합 산업 등 다양한 전방 시장 성장에 따른 초전도선재 시장 개화

핵융합 발전기에 사용되는 초전도선재 시장 성장 및 수요 증가

기존 일부 Lab 수준 장비 수요 → 양산 설비 수요 급증 전망



[한국의 인공태양 KSTAR. 한국핵융합에너지연구원 제공]



[핵융합발전기 스텔라레이터]



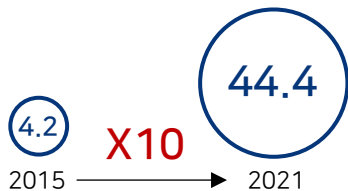
당사에서 개발 완료한
초전도선재 IBAD*증착 양산 설비



*IBAD : Ion Beam Assisted Deposition

지속적으로 증가하는 글로벌 핵융합 산업 투자

핵융합 분야 투자금 (단위: 억달러)



미국 핵융합발전 스타트업 타입원에너지 - 2억5000만달러(약 3430억원)에 달하는 대규모 시드 연장 투자 (머니투데이 2024.08)

한국 꿈의 에너지 핵융합, 1조2000억 프로젝트 띄운다.(조선일보 2024.07)

중 핵융합로 건설 박차...태양 7배 뜨거운 '인공 태양' 만든다.(디지털투데이 2024.01)

실리콘밸리 억만장자들이 핵융합에 투자하는 것은 화석연료에서 벗어나 수소 핵융합을 통한 무한 에너지 생산이 가능하기 때문이다. 핵융합 연료 1g은 석유 8톤에 해당하는 에너지를 생산할 수 있다. 육조 반 분량의 바닷물에서 추출할 수 있는 중수소와 노트북 배터리 하나에 들어가는 리튬의 양 정도로 한 사람이 30년간 사용할 수 있는 전기를 생산할 수 있다.



빌게이츠

제프 베이조스

최첨단 산업에 적용되는 제품으로 글로벌 장비 시장 진입



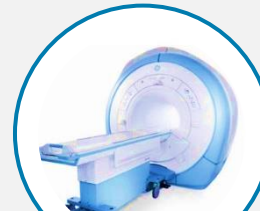
에너지



모빌리티



우주항공



의료



국방

Medium-and Short term Growth Strategy

01 단기 성장 전략

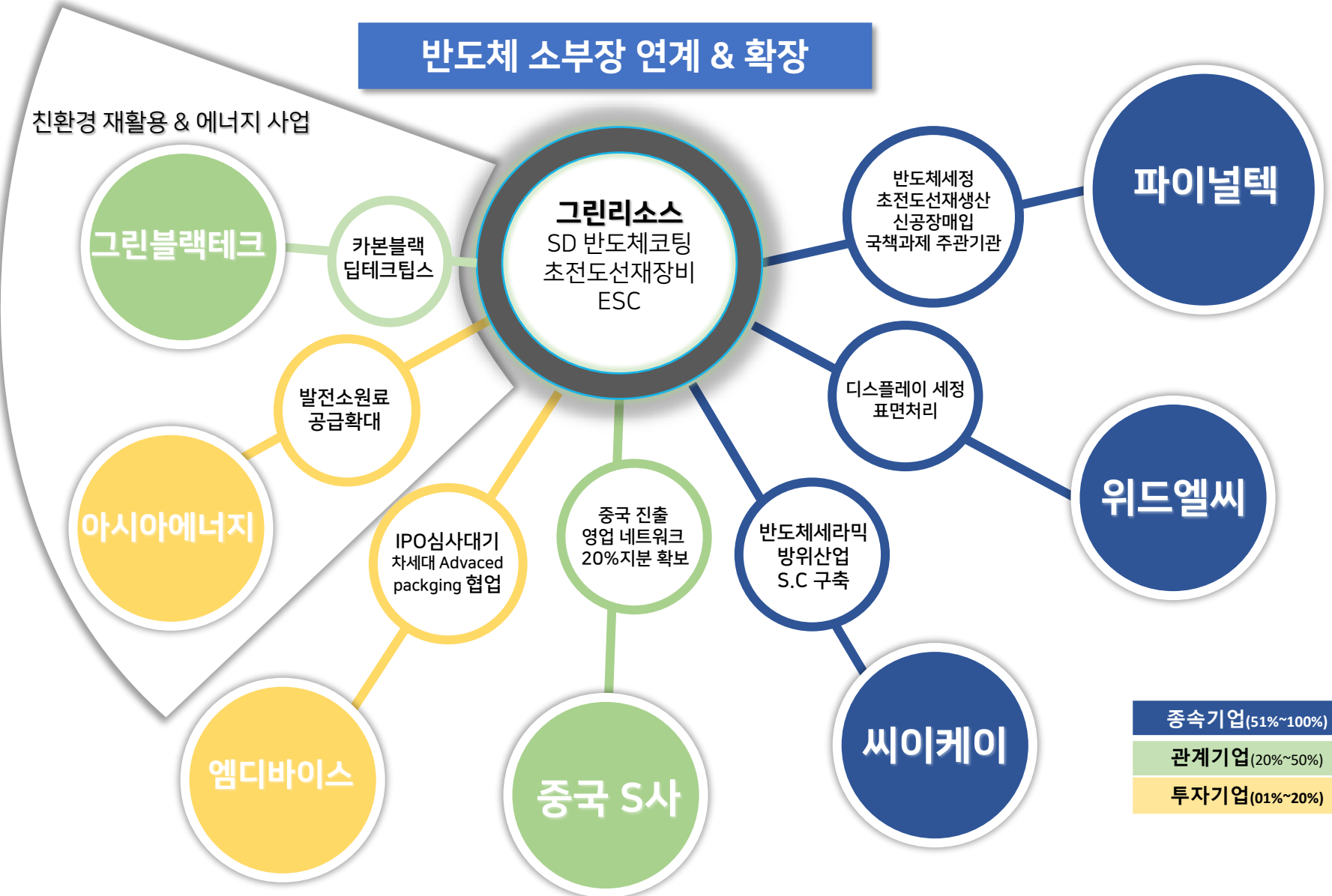
02 중기 핵심 성장전략

03 경영성과 - 주요지표



반도체 소부장 연계 & 확장

친환경 재활용 & 에너지 사업



종속기업 (51%~100%)
관계기업 (20%~50%)
투자기업 (01%~20%)

03 중기 성장전략 - (주)씨이케이

일반 현황

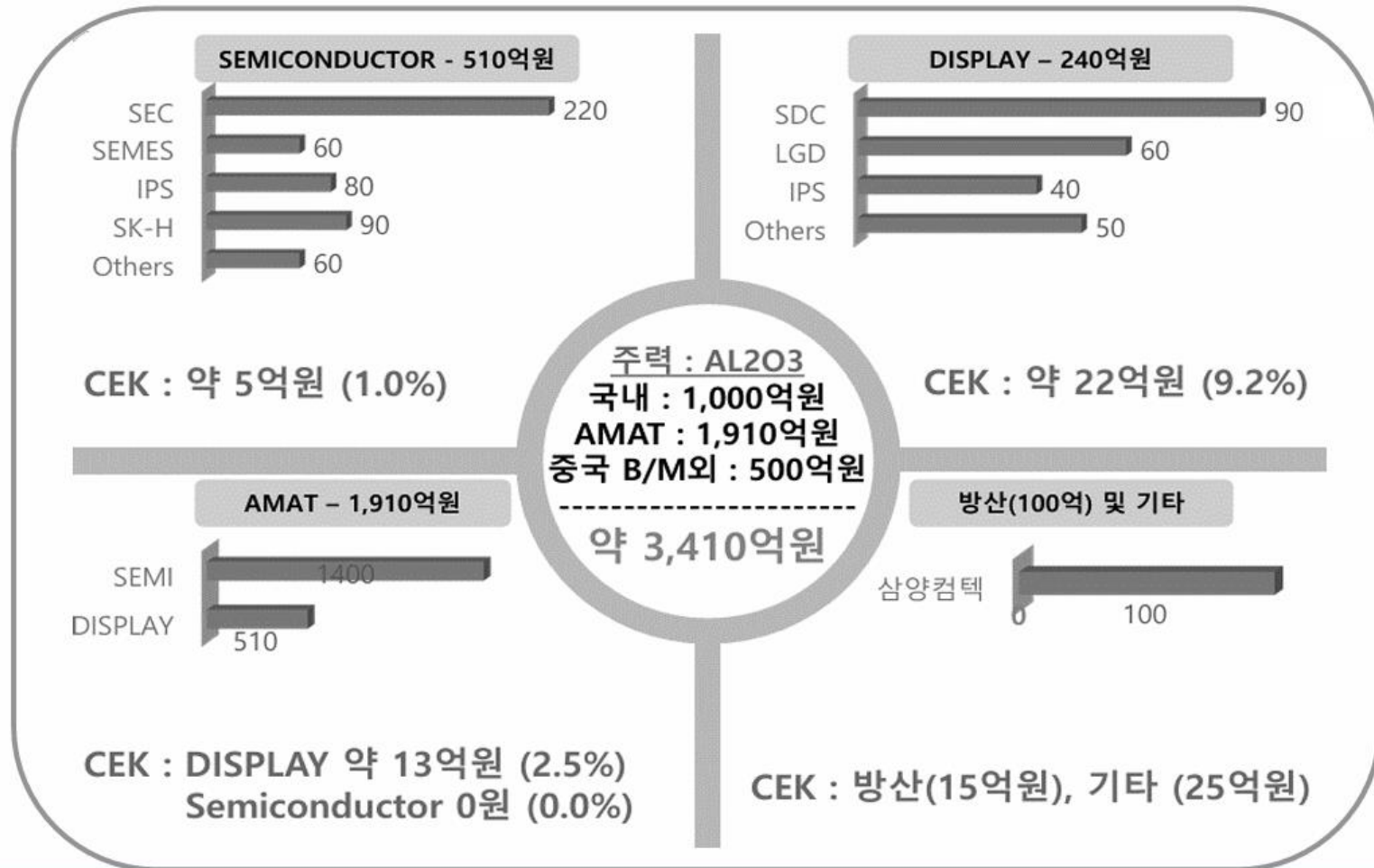
회사명	(주)씨이케이	
대표이사	김범주	
설립일	2008년 4월	
자본금	1억원	
주요사업	반도체 & 디스플레이 장비용 세라믹부품 제조 방위산업 방탄제품 정밀가공	
임직원수	46명(2024.9월 현재)	
소재지	경기도 안성시 원덕면 천덕산로 681-15	
홈페이지	http://www.ceramiceng.co.kr/	



세라믹가공 특허기술 바탕으로 Applied Materials와 계약한 국내 유일 등록업체
국대최대 세라믹 가공설비(93대) 보유

Track Record

대상회사는 2023년 국내외 세라믹시장 시장점유율 약 2.3%로 국내 및 해외수출까지 레퍼런스를 쌓아가고 있습니다.



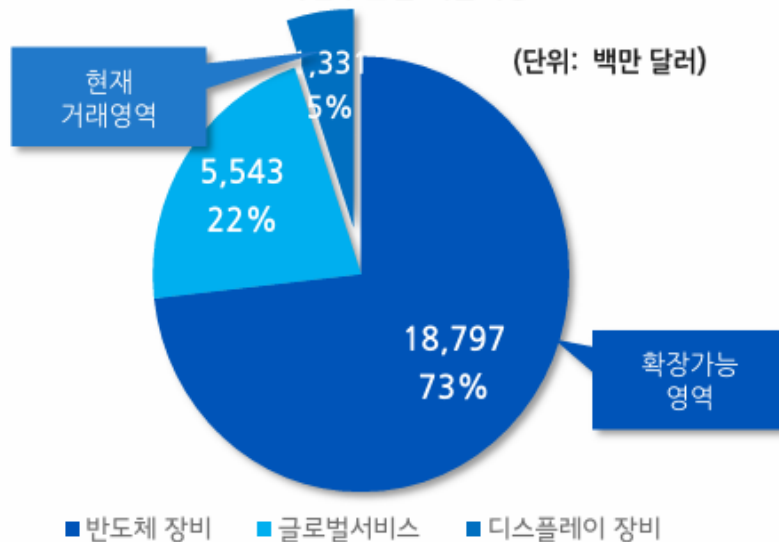
03-2 CEK - 주요 사업 및 제품계획

대상회사는 최근 Applied Materials의 고정물량 공급 요청으로 협력관계 강화되고 있고, AMAT의 품질 신뢰 확보를 통한 반도체 장비시장으로 사업확장을 검토 중에 있습니다.

AMAT과 전략적 협력강화 및 신규시장(반도체 장비시장) 진입

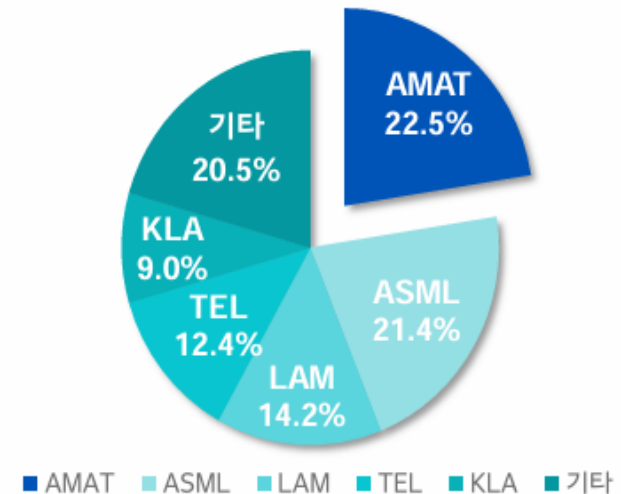
- ✓ 국내 AMAT 등록업체인 CEK에 대한 전폭적인 지원 (Kyocera의 사업축소로 새로운 파트너십 필요)
- ✓ 신규 투자설비인 CIP에서 생산한 Shaft의 고정적인 공급을 요청. 하반기 본격 공급예정
- ✓ AMAT과 협력관계인 디스플레이부문은 AMAT 매출의 5%에 불과. 품질 신뢰 확보 후 반도체장비 부문 신규 진입 가능
- ✓ AMAT은 현재 반도체장비 글로벌 시장점유율 1위업체로 시장진입시 큰 규모의 매출증대가 가능할 것으로 예상.

AMAT 사업부문별 매출비중



(Source: AMAT)

반도체 장비 글로벌 시장점유율



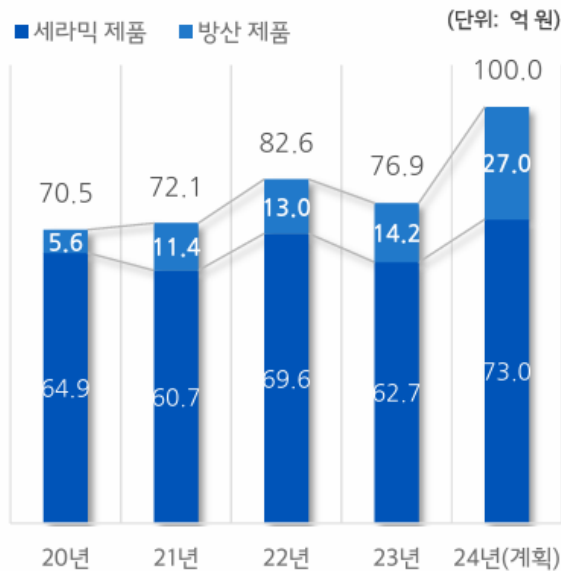
(Source: 테크인사이드)

대상회사는 국내 방산업체 대규모 수주 확대로 풍산, 삼양컴텍 등 국내 주요 방산업체로 매출 증가 추세에 있습니다.

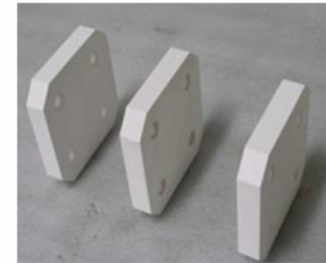
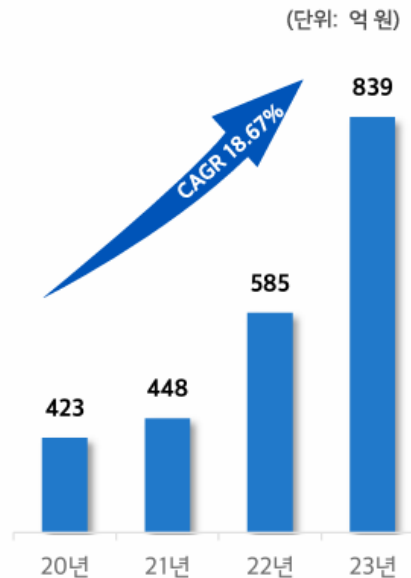
방위산업체 매출 증대

- ✓ 방산업체 삼양컴텍向 CEK 매출 증대: 20년 5억원→23년 14억원으로 증대. 2025년 50억원 이상까지 확대 계획
- ✓ 2028년까지 연평균 11%수준의 방위력개선 예산 증가 확정으로 방위산업체의 매출증가가 전망

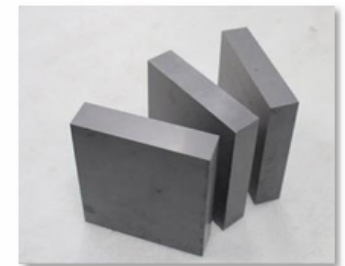
CEK 방산 매출 추이



삼양컴텍 매출추이



방탄용 Al₂O₃



방탄용 SiC

기대효과

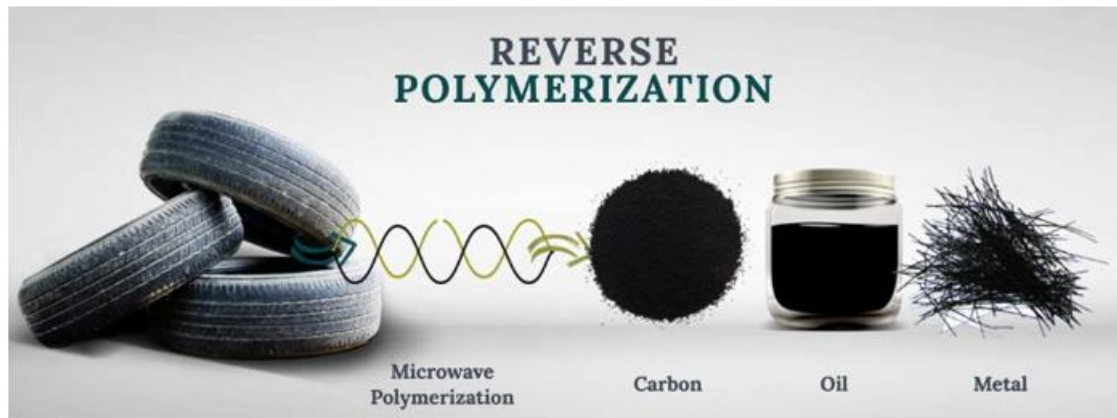
1. 고객사 네트워크 공유를 통한 시너지
 - AMAT, CXMT 등
2. Supply Chain의 수직계열화 (부품 & 코팅)를 통한 효율성 증대.
 - 납기, 영업비용, 생산원가 절감 등
3. 반도체 정밀세정 협업을 통한 반도체 부품 진출속도 단축.
 - 그린리소스의 SiC, ESC 등의 반도체 부품기술 제공 → 정밀가공 업체 → 반도체 정밀 부품업체로의 성장.

중기계획

- 2025년 연내 투자 유치 : 약 100억원 (300억 Value 수준)
- 2026년 반도체 세라믹 부품 양산라인 구축 및 양산 기술 확보.
- 2027년 IPO 청구. (세라믹 매출 약 300억원 / 기타 부품 매출 약 200억원)

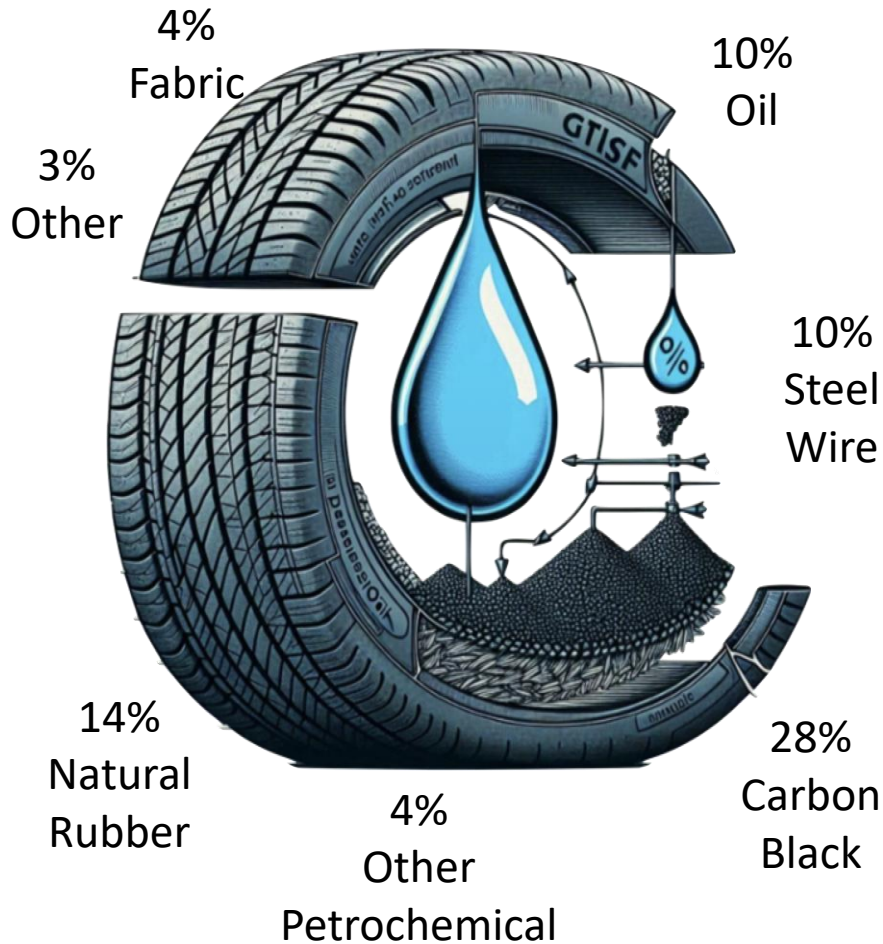
1. 기술개발 요약 (Solution)

- 효율적인 마이크로파 가열 **양산** 시스템 개발
 - 페타이어의 열분해를 위한 고효율 마이크로파 발생 양산 시스템 개발
- **양산** 공정 자동화 시스템 개발
 - 최소 인원으로 고품질 회수를 위한 자동화 시스템 개발
- 고부가가치 제품 회수
 - 고순도 카본블랙, 오일, 가스 등의 제품 회수율 증대 및 품질 개선.



*출처 : <https://weibold.com/canadian-10-million-joint-venture-to-recycle-tires-using-microwave-technology>

페타이어 구성요소 성분 및 재생 개념



Refined Oil
(30~40%)



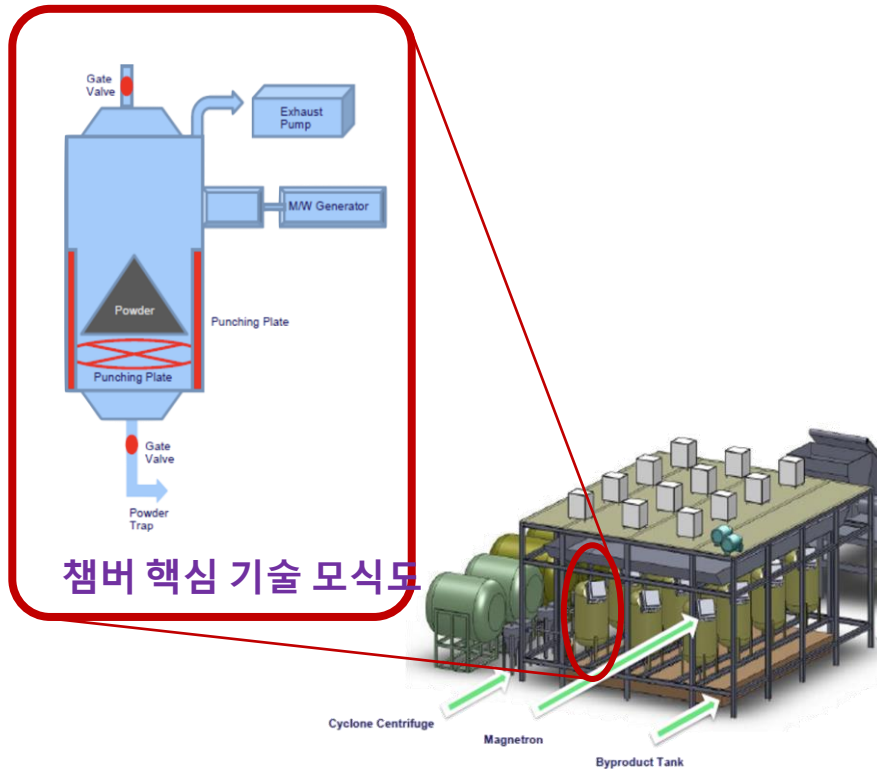
Carbon Black
(25~28%)



Steel Wire
(10%)

Gas (Possible Use)
(20 ~ 30%)

핵심 기술(ICMD)



• 구조 및 운영:

- 독립 챔버 연결형 구조 → 유연성 확보
- 진공 상태 유지 → 오염물질 최소화 및 안전성 증대

• 효율성 향상:

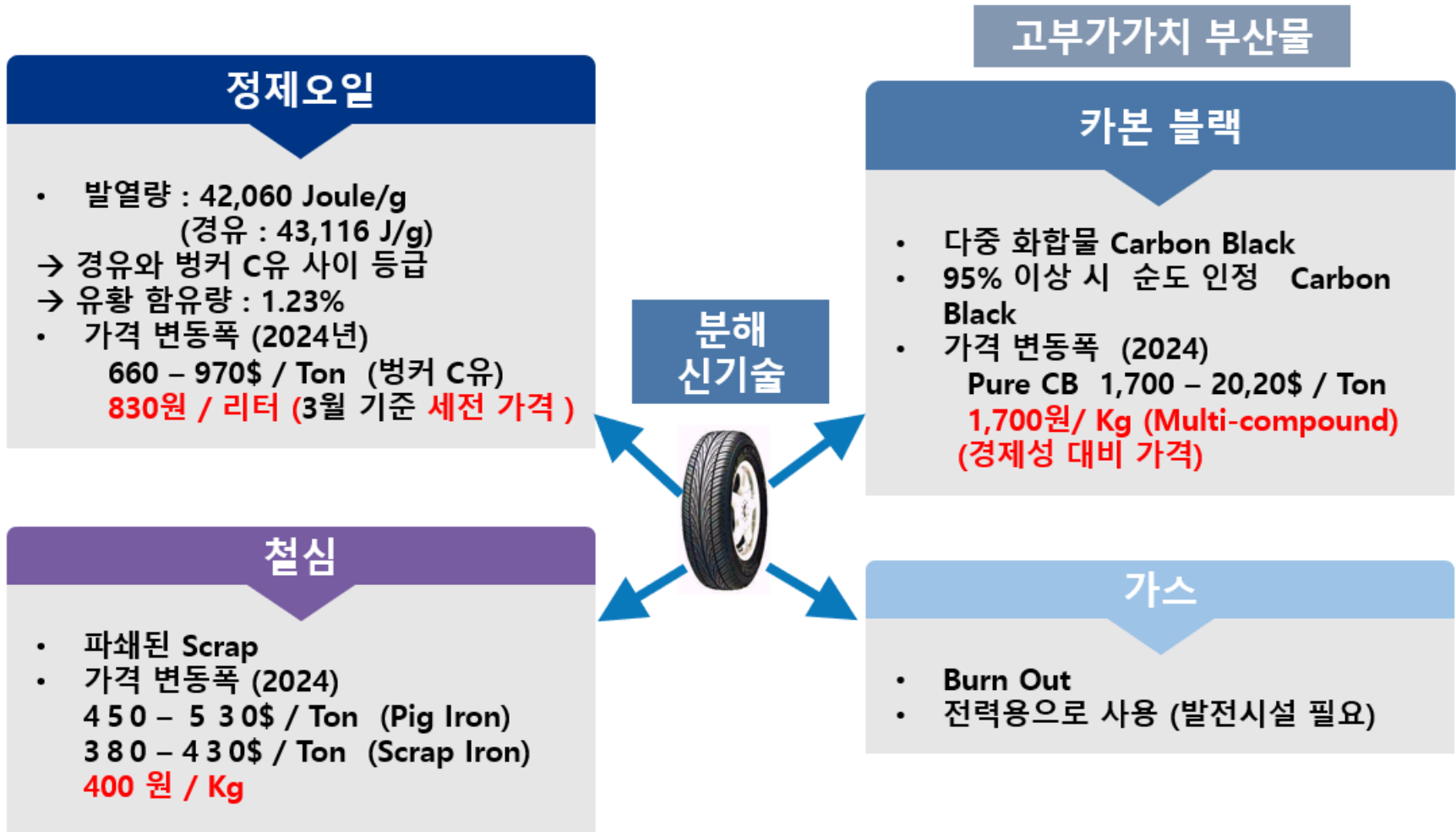
- 철심 분리 및 분쇄 타이어 사용 → 처리 효율 개선
- 마이크로웨이브 반사 방지 → 에너지 효율 증대

• 고품질 산출물:

- 철심과 섬유 제거 → 고순도(>95%) 카본블랙 추출

• 장치 최적화:

- 최소화된 장치 용적을 → 공간 효율성 증대
- 공정 속도 증가 → 생산성 향상 및 비용 절감



04-4 그린블랙테크 - 성장예측

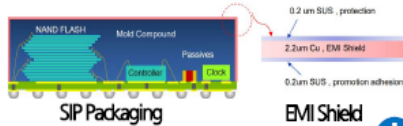
년도	매출	제조경비+판관비	영업이익	자본총계	비고	
2024	0	200	-200	200	3억원 투자유치 (팁테크 팁스 선정)	개발비는 국책 과제(TIPS자금으로 총당)
2025	0	300	-300	900	10억원+ @ 투자유치 (스케일업 팁스)	개발비는 국책 과제(TIPS자금으로 총당)
2026	2,200	1,170	1,030	11,930	100억원 투자유치(SI)	하반기부터 20톤/일 생산 기준
2027	8,800	3,924	4,876	36,806	200억원 투자유치(FI)	40톤/일 생산 기준
2028	33,000	17,050	15,950	52,756	IPO청구	100톤/일 생산기준 하반기부터 미국 100톤/일 생산기준

- SI는 타이어 제조사 및 정유사를 1순위로 고려중.
- 자본금은 1억원으로 (주)그린리소스의 지분률은 20%
- 현재 딥테크팁스 선정으로 그 기술력을 인정받음.
- 엘디카본 보다 더욱 정제된 오일을 더 작은 동력비로 회수 가능

업계 내 독보적 기술력과 가격경쟁력을 바탕으로, 스토리지 시장 선도

메가일렉트로닉스의 경쟁력

1. Advanced Packaging 기술력



SSD 소형화의 핵심인 SIP 기술과 자체 개발한 EMI Shield 기술 보유
→ 차세대 반도체 생산의 핵심 기술

2. 폭넓은 제품 라인업



소형화, 고성능화 트렌드에 적합한 설계 및 패키징 기술력 보유
→ 개인용, 산업용 등 전 분야 SSD 자체 생산 가능

3. Full-Turnkey 서비스 제공



SSD 자체 설계 및 조립, 테스트 기술 보유
→ SSD 제작에 대한 Full-Turnkey 서비스 제공 가능

**"독보적 패키징 기술력을 토대로
개인용, 서버용 SSD 시장을 선도"**

메가일렉트로닉스의 경영 방향성

SSD 개발 및 제조업

- ▶ 국내 유일 설계부터 제조까지 가능한 중소기업
- ▶ 세계 4번째로 BGA SSD를 개발, 차세대 SSD 개발 및 제조 기술역량 보유



패키징 전문 업체 (OSAT)로의 전환

Advanced Packaging 기술력

- ▶ PCB Base로 적응에 대한 이론과 기술 축적
- ▶ IDM의 TSV (Through-Silicon Via) 제조 보편화 될 시, 이종간 수직 결합 등 다양한 패키징의 설계 및 제조 가능

'25FY 예상순익 96억

매출액 및 제조원가율 추정 실적

1. 매출액 조정

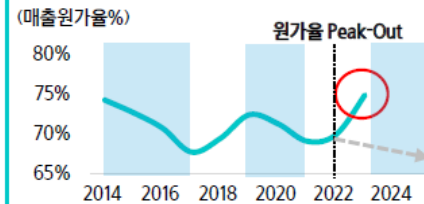
(억원, %)	2022A	2023E	2024E	2025E	2026E
기존추정 매출액	163.9	293.9	471.4	692.3	865.4
조정 매출액	163.9	182.0	454.9	682.3	852.9
YoY Growth	n/a	111.0%	250.0%	150.0%	125.0%
기존매출 달성률	n/a	61.9%	96.5%	98.6%	98.6%

조정 사유

- 2023년 3분기 실적이 기존 추정치를 크게 하회
- 2023년 4분기 반도체 Turn-Around 본격화 가정
- 2024년 기저효과 및 대형고객사와의 공급계약 체결로 급격한 매출 증가

2. 제조 원가율 조정

SSD 제조업체 7개사' 원가율 추이



조정 사유

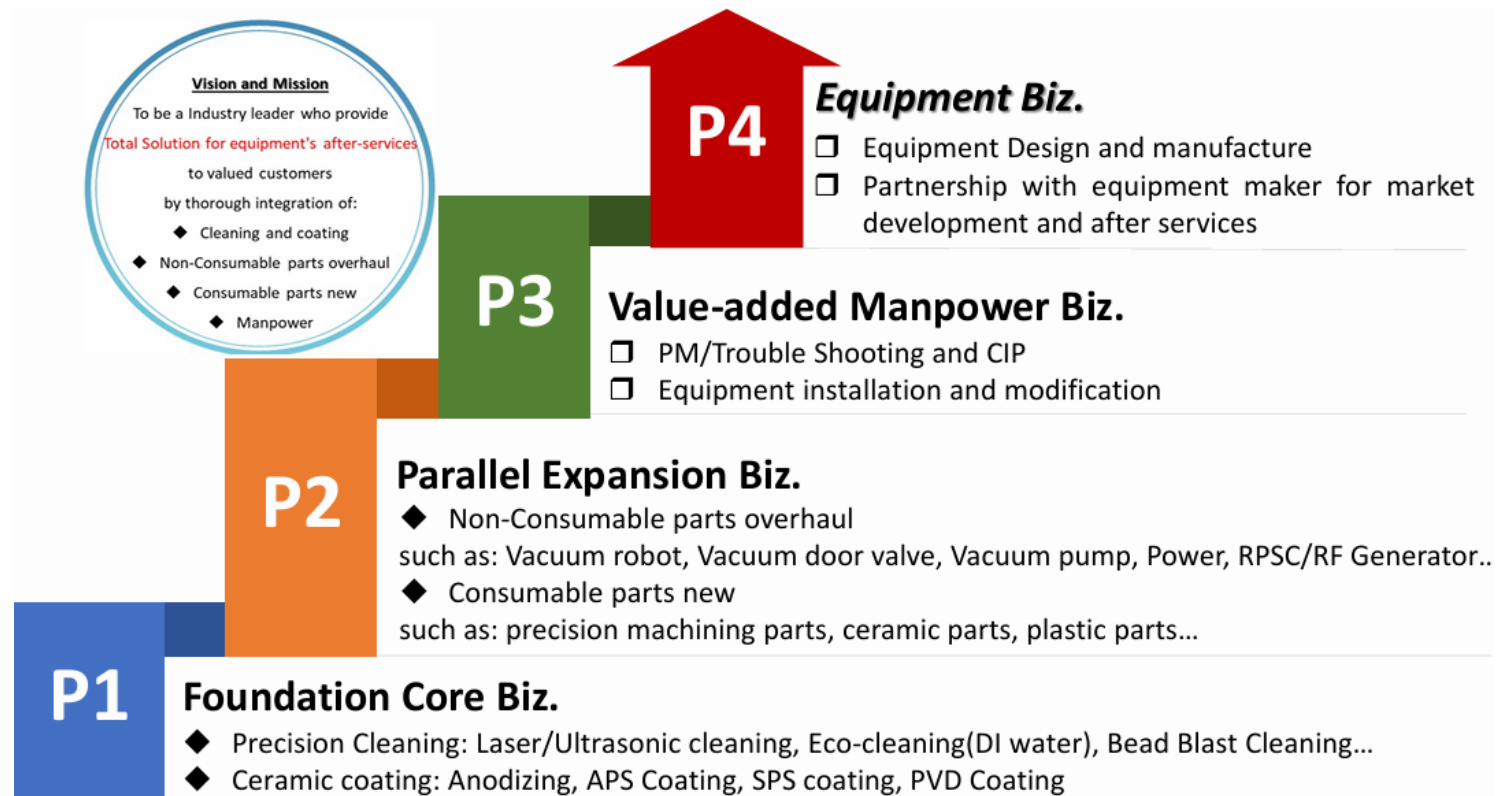
- SSD산업은 높은 매출원가율 및 Cyclical한 특성을 보임
- SSD주도 NAND Big Cycle 진입에 따른 수익성 개선 가정
- 전자파차폐, BGA SSD 등 기술 혁신을 통해 원가 절감 가정

추정실적 검토내역	(억원,개)	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	검토 내용	조정여부
	매출액		164	182	455	682	853	- 2023년 H1 및 3Q 실적이 기존 추정치를 큰폭으로 하회. 추정 Base가 되는
글로벌 SSD 시장규모		403,488	460,110	524,677	598,306	682,267	2023년에 대한 조정 불가피	0
- 회사 시장 점유율		0.04%	0.04%	0.09%	0.11%	0.13%	- 3분기 실적, 산업 현황 및 대형고객사와의 장기계약 수주를 가정하여 조정 - SSD 시장규모 성장 고려 시 시장점유율 수준 타당	
제조 원가		126	177	364	525	631	- 회사가 가정한 80% 원가율은 비교회사들의 제조원가율 대비 과도한 수준,	0
- 매출원가율		77.2%	97.1%	80.0%	77.0%	74.0%	제조원가율 '23년 97.1%에서 '26년 74% 수준으로 점진적 감소 가정 (벤치마크 Innodisk 66.7%, Seagate 70.3% 고려)	
매출총이익		37	5	91	157	222		
판매관리비		21	17	23	33	41		
영업이익		17	-12	68	124	180	- 회사의 가벼운 비용구조를 감안했을 때, 적정수준의 인건비 및 판매수수료로 판단됨	X
- 영업이익률		10.1%	-6.4%	14.9%	18.2%	21.2%		
영업외손익		-18	10	-5	-5	-5	- PCB 사업부 매각으로 인한 유형자산처분이익 반영 - NAND 재고 평가손실 25억원 가정 (재고원가 40억원, NAND 당 \$8 → \$3)	0
당기순이익		1	-6	51	96	142		

Note 1. SSD 제조업체 ADATA, Innodisk, Pure Storage, Seagate, Shenzhen Longsys, Transcend Information, Western Digital 7개사의 제조원가율 평균치

중국 - S사 (20% 지분 확보 협의 중 / 연내 계약체결 목표)

- 중국시장 포기X → 현지공장 설립 리스크 高 → 기반 시설 & 영업 네트워크 우수한 중국 현지회사 지분확보
- 중국 현지 반도체 & 디스플레이 부품 & 장비 시장을 공략하여 공동의 이익 증대 및 중국 현지 IPO를 목표로 함.



1. 증착기 ESC 양산DEMO 샘플 제작 중

- 25년 3월 양산시작 목표, 년 100~200억 매출 타겟

2. 국내 반도체 대기업의 의뢰로 미국 독점 반도체 특수 증착소재 개발 중.

- 개발 성공시 국내 유일 제조업체 / 시장 규모는 아직 파악중.

3. 아시아에너지와의 발전소용 원료 전략적 공급계약

- 연간 200억원 이상 추정

4. 그린리소스 초전도선재 IBAD 증착장비 추가 발주 협의 중

- 2025년 수주 가능성 高 / 2~3 대

5. 종속회사 파이널텍, 2026년부터 초전도선재(초전도체) 본격 양산 시작목표.

- 주력사업인 반도체 정밀세정도 증가예상
- 신규 공장 매입 완료

Q & A



Appendix



01 요약분기별 실적

손익계산서(연결)

단위: 백만원

구분	2023 4Q	2024 1Q	2024 2Q	2024 3Q
매출액	4,576	4,068	4,348	4,362
매출원가	2,248	2,344	2,526	2,920
매출총이익	2,328	1,725	1,822	1,442
판매비와 관리비	1,368	1,090	1,234	1,129
영업이익	959	635	587	313
영업외수익	193	314	227	536
영업외비용	(86)	67	259	509
당기순이익	911	863	465	340

손익계산서(별도)

단위: 백만원

구분	2023 4Q	2024 1Q	2024 2Q	2024 3Q
매출액	3,427	2,942	3,284	3,219
매출원가	1,465	1,621	1,887	2,258
매출총이익	1,962	1,321	1,397	961
판매비와 관리비	1,146	891	987	880
영업이익	816	430	411	81
영업외수익	175	299	211	525
영업외비용	(92)	65	256	495
당기순이익	1,243	646	334	112

02 요약재무제표(연결)

재무상태표

단위: 백만원

구분	2021	2022	2023	2024 3Q
유동자산	6,278	8,645	21,246	27,273
비유동자산	23,821	26,074	50,091	65,072
자산총계	30,099	34,719	71,337	92,345
유동부채	11,189	11,188	10,347	8,853
비유동부채	3,177	2,560	9,860	24,812
부채총계	14,366	13,748	20,207	33,665
자본금	3,167	3,247	4,092	4,133
자본잉여금	2,416	4,031	30,598	31,950
기타자본	226	303	449	4,938
이익잉여금	9,923	13,389	15,991	17,659
자본총계	15,732	20,970	51,130	58,680

손익계산서

단위: 백만원

구분	2021	2022	2023	2024 3Q
매출액	13,659	25,084	16,501	12,779
매출원가	7,823	17,028	9,524	7,790
매출총이익	5,836	8,056	6,977	4,989
판매비와 관리비	2,728	4,325	3,079	3,454
영업이익	3,108	3,731	3,268	1,535
영업외수익	221	675	512	1,077
영업외비용	1,918	328	374	834
법인세차감전 순이익	1,396	4,078	3,406	1,777
당기순이익	1,156	3,465	2,602	1,668

03 요약재무제표(별도)

재무상태표

단위: 백만원

구분	2021	2022	2023	2024 3Q
유동자산	5,293	7,407	19,131	25,471
비유동자산	22,380	24,784	49,238	59,899
자산총계	27,674	32,191	68,369	85,370
유동부채	10,497	10,648	9,736	8,270
비유동부채	2,883	2,428	9,738	21,231
부채총계	13,381	13,076	19,474	29,502
자본금	3,167	3,247	4,092	4,133
자본잉여금	2,416	4,031	30,599	31,950
기타자본	226	304	449	4,938
이익잉여금	8,484	11,534	13,756	14,848
자본총계	14,293	19,115	48,895	55,869

손익계산서

단위: 백만원

구분	2021	2022	2023	2024 3Q
매출액	10,874	21,432	12,192	9,445
매출원가	6,377	14,754	6,824	5,766
매출총이익	4,497	6,678	5,368	3,679
판매비와 관리비	2,012	3,255	2,995	2,757
영업이익	2,484	3,423	2,373	922
영업외수익	176	661	466	1,036
영업외비용	1,902	310	359	816
법인세차감전 순이익	758	3,774	2,480	1,142
당기순이익	542	3,049	2,222	1,092